

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】令和 1 年 11 月 7 日 (2019.11.7)

【公表番号】特表 2018-531323 (P2018-531323A)

【公表日】平成 30 年 10 月 25 日 (2018.10.25)

【年通号数】公開・登録公報 2018-041

【出願番号】特願 2018-516838 (P2018-516838)

【国際特許分類】

C 2 3 C 16/46 (2006.01)

【FI】

C 2 3 C 16/46

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 9 月 25 日 (2019.9.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0036

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0036】

第 1 形態 300 では、サセプタ 120 は、予熱リング 326 の厚さ T1 に実質的に等しい厚さ T1 を含む。さらに、予熱リング 326 の表面 378 は、サセプタ 120 の表面 129 と実質的に同一平面上にある。第 1 形態 300 では、隙間 325 は、サセプタ 120 の形態係数を増加させるために比較的大きく、その結果、SOI ウエハのエッジとサセプタの縁との間の温度勾配を減少させ、ウエハのスリップを減少させる。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

१७६